



HG3275B

产品规格书

标准

-

成分(w.%)

Ag: 73-77 | 玻璃粉: 3-6 | 树脂: 2-5 | 溶剂: 16-22

技术性能

细度 (μm): ≤ 7.5

固含量 (%): 80 ± 2

推荐烧结温度 ($^{\circ}\text{C}$): 580-620

· 粘度 ($\text{Pa}\cdot\text{s}$): 80-150

· 附着力 (N): ≥ 50

· 推荐烧结时间 (min): 50-60

可制造能力

银浆细度: $\leq 7.5\mu\text{m}$

粘度: 可根据客户需求调整

应用

用途: 适用于多种陶瓷基材, 用于制作压敏电阻元器件。

特点: 本产品适配工艺窗口宽, 可匹配多种规格陶瓷基材使用, 具有优异的附着力、导电性及抗老化能力。

储存条件

本产品应密封储存, 储存环境温度 $5-30^{\circ}\text{C}$, 置于干燥、阴凉、通风良好的环境中。